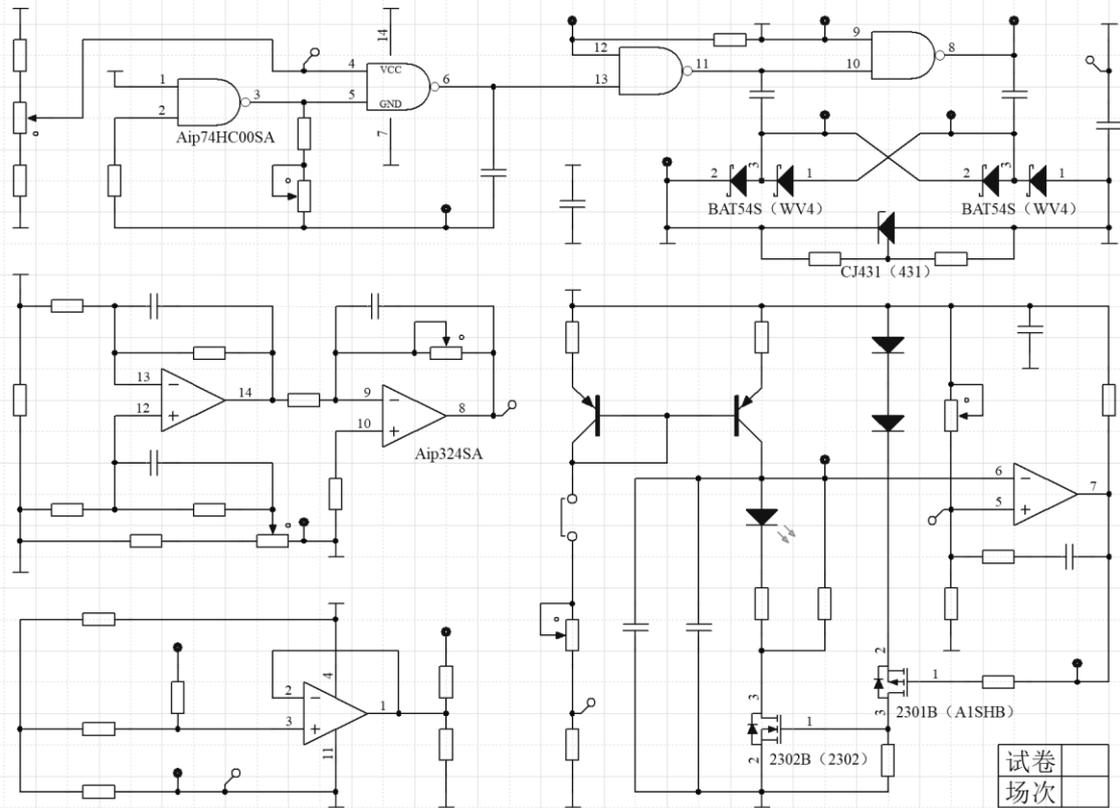


# 江苏省 2024 年中职职教高考

## 电子专业技能考试 技术公开信息说明

### 一、电子产品的电路原理参考图



### 二、说明

1. 上图为实际卷面中产品原理图的参考图，6 种器件型号及 4 种采用 SOT23 封装器件的丝印标识码如图。套件包括 1 个内装有元器件的材料袋和 1 块 PCB。按照试卷清单及装焊要求，参考装配图，对照 PCB 及元器件实物，合理安排装焊工序完成 PCB 组装。各场次装焊工艺要求、步骤及工作量完全相同。
2. 电子产品是直流电流表，单电源供电。短路帽用来通断直流电流测量对象，被测电流小于 3mA；
3. 试卷清单中有 4 个 2 种特殊阻值的电阻元件（其 PCB 封装的焊盘间距为 0.4mm，比普通 0805 封装间距小）并无下发实物元件。阻值为 0 欧姆的电阻需要使用焊锡短接，方法是合理控制烙铁头及其温度，在指定电阻的两个焊盘上堆锡，冷却后两个焊盘为短接状态；阻值为  $\infty$  的电阻，焊盘保持开路，无需装焊处理；
4. 套件中有 1 颗 3528 封装的单体超高亮 LED，该器件封装的缺口侧为阴极标识。该器件为易损器件，焊接温度和时间应合理控制。其设计用途为信号指示，点亮时亮度可能较暗；
5. 套件中有 6 个 3362P-1 型单圈电位器，注意不同规格及对应安装的位置，调试操作时注意方向和微调；
6. 套件中的 2 个插件三极管要求基极管脚整形后再悬空垂直安装，底座平面距 PCB 安装面 2~3mm，高度相当；其它元器件贴板装焊。各插件底部引脚垂直伸出 PCB 表面 1.4~2.0mm，单排针贴板装焊后不必剪脚；
7. 套件无冗余材料，其中有 1 根 13 位单排针，除了短路帽的底座使用 2 位，有且只有 11 个单排针测试点需要装配。试卷清单中的 13 个单排针测试点指定了 2 个测试点空置，不允许装配；
8. 套件中外观相似的元件可按照数量或体积或标识码区分，清点种类及数量无误并完成指定元件检测后有序装焊。未开始焊接前，材料有残缺的（含 PCB）填错漏补料申请，经核实后立即补料，不限时，不扣分；开始焊接后需要补料的（不含 PCB），请及时填写损失补料申请，损失补料在开考 30 分钟后按申请单有序进行核实下发，按实际下发的元件个数扣分；
9. 试卷第七项的项目配分为 9 分，每空 1 分；第八项、第九项的项目配分各场次略有差异，每空 2 分。